



2023年12月期第3季度 決算説明材料

株式会社 RS Technologies

2023年11月13日



Prime市場
3 4 4 5

目录

1. 公司概况 P.3

公司概况
历史沿革
制造基地介绍
现在的RS Technologies
晶圆再生业务各地区工货量构成比

截至2.2023年12月的第三季度结算摘要 P.14

第3季度决算概要 (累计)
第3季度细分趋势 (累计)
决算概况 (7月-9月)
各事业动向 (7月-9月)
各事业动向 季度业绩图
资产负债表

3. 中期管理计划 (23年至25年) P.21

中期经营计划概要
截至2023年12月期 决算业绩预测
设备投资计划: 晶圆再生业务、Prime Wafer业务
中国投资计划 (日程)
中国12英寸Prime Wafer (市场战略)
晶圆再生事业的需求客户
地域战略
再生晶圆的需求前景
第3成长引擎: DG Technologies成长战略
RS Technologies的愿景

Appendix P.35

董事长方永义的优势
硅片再生业务(1) (2)
进军PRIME WAFER行业
关于我们在中国的合资伙伴
山东省德州市的合作: 背景、经过及现状
中国业务的出资方案
12寸PRIME WAFER的事业方案
中国子公司 (GRITEK) 的上市和资本政策
中国子公司 (GRITEK) 上市时的状况
业绩变化・主要财务报表・各事业业绩推移

1. 公司概况

公司概况

- 硅片再生占全球市场30%份额的龙头企业※1。
- 与中国中央政府直辖国有企业合资，全面进军PRIME WAFER业务。
- 通过M&A将业务扩展到可以实现协同效果的相关业务领域。

公 司 的 名 字	股份公司 RS Technologies
设 立	2010年12月10日
经 营 理 念	「爱护地球环境，赢得世界各地客户的信赖，坚持不懈创造挑战」
业 务 内 容	电子材料、电子器械元件、通信器械元件材料的制造、加工、再生、销售，太阳能发电业务。旧半导体设备的收购和销售业务。半导体材料和元件的销售。半导体硅片制造的技术咨询服务。
总 部 所 在 地	东京都品川区大井1-47-1 NT大厦12F
三 本 木 工 厂	宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2
资 本	5,438百万日元（2022年6月月底）
董 事 长	方永义
主要合并子公司	艾尔斯半导体股份有限公司（台湾）资本金 NT \$300 million 出资比例100%
	北京有研艾斯半导体科技有限公司（北京）注册资本US \$138 million 出资比例45% ※2
	有研半导体硅材料股份公司（北京）注册资本 10亿人民币 出资比例47.17% ※2
	株式会社Union Electronics 资本金 27百万日元 出资比例100%
	山东有研半导体材料有限公司（山东省德州市）注册资本金15亿人民币 出资比例37.74% ※2
	株式会社DG Technologies 资本金 100百万日元 出资比例100%

※1 根据SEMI数据 本公司进行估算。

※2 截至2022年12月末

历史沿革

■ 晶圆再生业务的全球领导者。与中国一家主要PRIME WAFER制造商合资成立子公司，晋升为硅片综合制造商。

2010年 12月	以硅片再生业务为主要业务，成立株式会社RS Technologies
2014年 2月	在台湾成立子公司——艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）
2015年 3月	在东京证券交易所创业板上市
2015年 6月	引进最先进设备（可再生18英寸硅片）的三本木工厂和第8工厂竣工
2015年 12月	艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）的台南工厂竣工
2016年 9月	变为东京证券交易所主板上市企业
2018年 1月	成立北京有研RS半导体科技有限公司（BGRS），将中国PRIME WAFER制造商有研半导体材料有限公司（GRITEK）变为合并子公司
2018年 5月	取得100%的株式会社Union Electronics的股份
2018年 8月	设立山东有研半导体材料有限公司（GRITEK合并子公司、山东GRITEK）
2019年 1月	取得株式会社DG Technologies（DG）100%股份
2019年 12月	有研科技集团有限公司（GRINM）、德州汇达半导体股权投资基金合作企业及山东省德州市政府之间签订四方合并合同（SGRS）
2020年 2月	成立上海悠年半导体有限公司（上海悠年）
2020年 3月	成立山东有研RS半导体材料有限公司（SGRS）及有研艾唯特（北京）科技有限公司（北京IVT）
2020年 10月	中国的PRIME WAFER生产据点山东GRITEK的新工厂竣工,开始生产。
2022年 3月	公司从设置监事会变更为设置监事等委员会
2022年 4月	公司设置提名薪酬委员会（可选）
2022年 6月	作为DG第2生产基地栗原工厂竣工（宫城县栗原市）
2022年 11月	以硅片再生业务为主要业务，成立株式会社RS Technologies
2023年 10月	设立株式会社LE SYSTEMS

三本木工厂 (RS Technologies、晶圆再生业务)

- 2011年1月开始运作
- 2015年6月，配备最先进设备的第8工厂开始生产



公司的名字	株式会社 RS Technologies
设立	2010年12月
产品	5、6、8、12英寸再生晶圆
生产能力	8英寸:月产15万片 12英寸:月产30万片
所在地	宫城县大崎市
认证	ISO9001、ISO14001

台南工厂 (RSTW,晶圆再生业务)

■2015年12月，艾尔斯半导体股份有限公司 (RSTW) 台南厂开始生产。



公司的名字	艾尔斯半导体股份有限公司
竣工	2015年12月
产品	12英寸再生晶圆
生产能力	12英寸:月产20万片
所在地	台湾台南市
认证	ISO9001、ISO14001

德州工厂 (山东GRITEK、8英寸PRIME WAFER业务)

- 2018年8月、设立山东有研半导体材料有限公司 (GRITEK的连结子公司、山东GRITEK)。
- 2020年10月、新工厂完成竣工,作为新的PRIME WAFER生产据点开始运行。



公司的名字	山东有研半导体材料有限公司
竣工	2020年10月
产品	5、6、8英寸PRIME WAFER
生产能力	5英寸: 月产5万片 6英寸: 月产20万片 8英寸: 月产13万片
所在地	中国山东省德州市
认证	ISO9001、ISO14001

SGRS研发中心(SGRS, 12英寸PRIME WAFER业务)

- 2020年3月、设立山东有研RS半导体材料有限公司 (SGRS)。
- 2021年设立月产1万片试验线、正在进行质量改进和批量生产的研究开发。



※图为中国北京SGRS研发中心



公司的名字	山东有研RS半导体材料有限公司
设立	2020年3月
产品	① 12英寸PRIME WAFER ② 12英寸再生晶圆
生产能力	① 月产1万片 (开发线) ② 月产5万片 (从2022年开始)
所在地	中国山东省德州市※

神栖工厂 (DG Technologies, 半导体相关设备, 部件等业务)

- 2019年1月、DG Technologies成为合并子公司。
- 为了满足不断增长的需求, 我们正在通过资本投资和生产力提高来增加产量。



公司的名字	株式会社 DG Technologies
设立	1981年10月
产品	干式刻蚀装置 石英、硅耗材
所在地	茨城县神栖市
认证	ISO9001

栗原工厂 (DG Technologies, 半导体相关设备, 部件等业务)

- 2021年5月, 在宫城县开设了栗原工厂
- 通过神栖工厂和栗原工厂 (新成立) 这两个传统的生产基地, 我们将响应增加的订单



硅电极



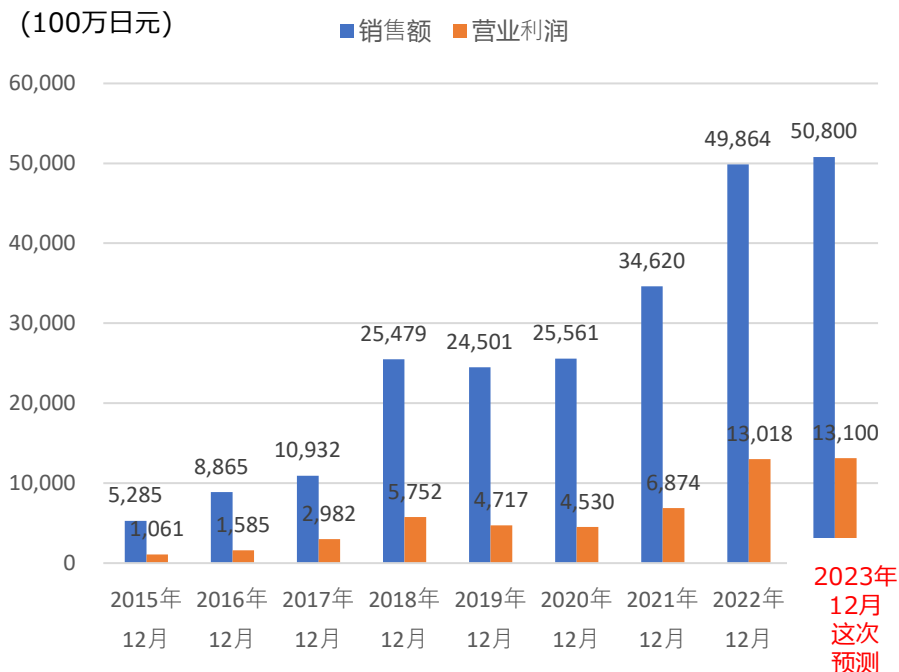
石英环

公司的名字	股份公司 DG Technologies
开始运行	2021年5月
产 品	干式刻蚀装置 石英、硅耗材
所 在 地	宫城县栗原市
建筑面积	5,000m ²

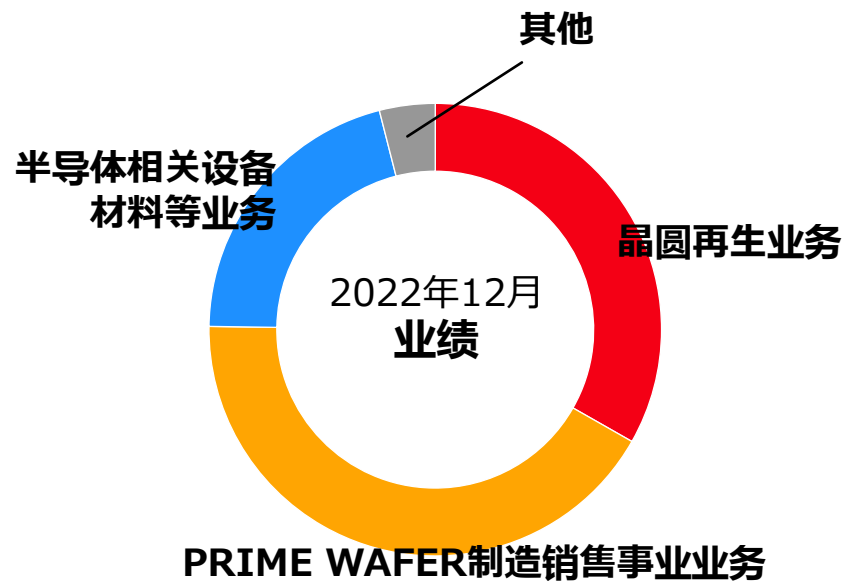
现在的RS Technologies

- 晶圆再生业务 + PRIME WAFER业务的综合晶圆制造商
- 在半导体相关设备部件等业务及太阳能事业领域扩展业务
- 晶圆再生业务在全球占领领先地位，PRIME WAFER业务以中国国内市场为中心开展业务。

合并营业收入及利润

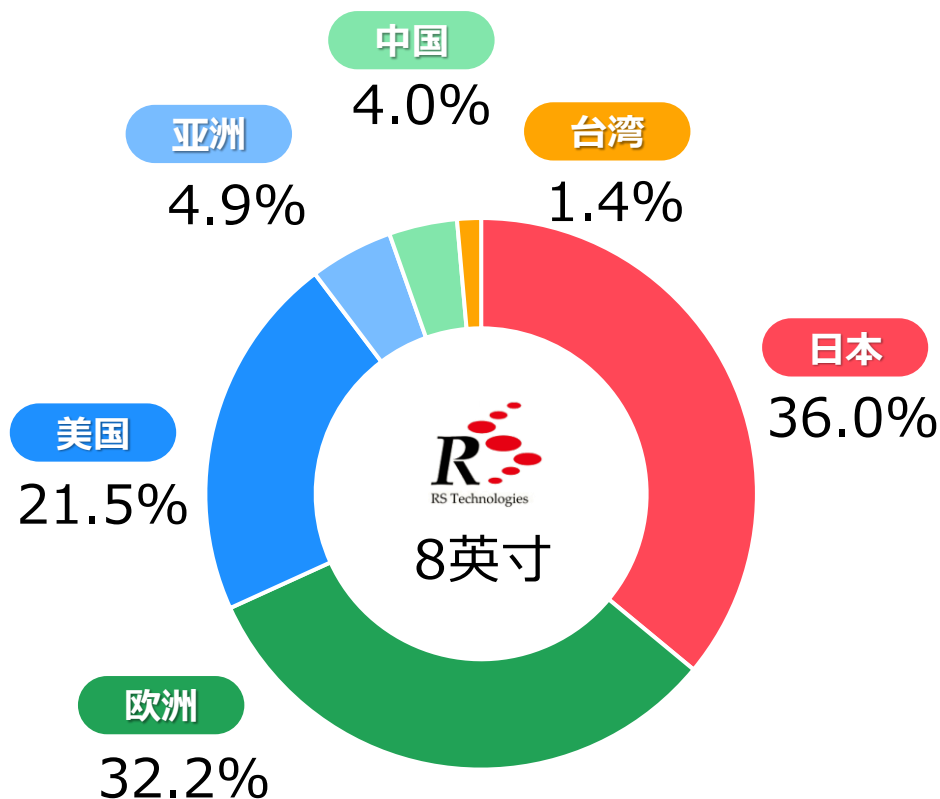
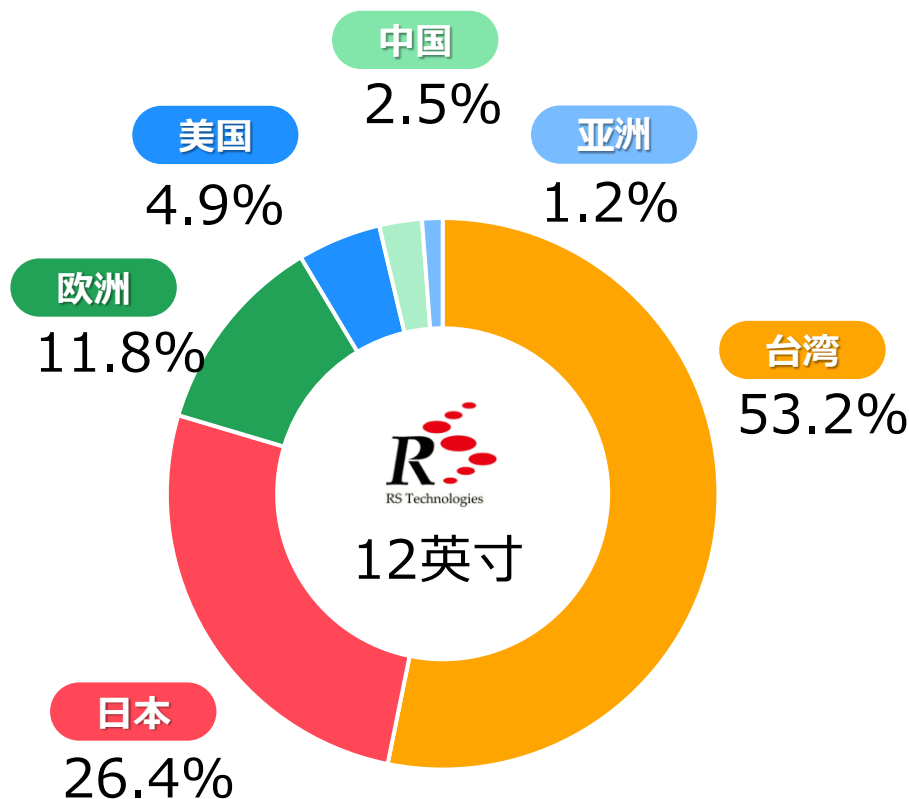


各业务领域营业收入



晶圆再生事业各地区供货量构成比

- 客户涵盖以日本、台湾、欧美为中心的世界主要半导体制造商。
- 日台中的3个生产据点可应对今后不断增长的供片需求。



(2023年度累计)

2. 截至2023年12月的第三季度结算摘要

截至2023年12月的第三季度结算概况

- 销售额， 营业利润， 普通收入和归属于母公司股东的净收入总体上保持良好
- 全年 (年度) 前景稳定

(100万日元)	2022年12月 第三季度	2023年12月 第三季度	前期比	前期比 增减率	2023年12月 全年预算 进度百分比	2023年12月 全年预算
销 售 额	37,633	39,470	1,837	4.9%	77.7%	50,800
营 业 利 润	9,778	9,576	△202	△2.1%	73.1%	13,100
营 业 利 润 比 率	25.9%	24.3%	△1.6pt			25.8%
经 常 利 润	12,269	12,017	△252	△2.1%	84.0%	14,300
经 常 利 润 率	32.6%	30.4%	△2.2pt			28.1%
归属于母公司股东 当 期 净 利 润	5,789	5,965	176	3.0%	80.6%	7,400
每 当 期 净 利 股 润	223.93日元	226.82日元	2.89日元	1.3%		286.18日元

截至2023年12月的第三季度（累计） 分段趋势

- 由于强劲的客户需求，晶圆再生业务比去年同期增加了销售和利润
- PRIME WAFER业务，因市场环境发生变化等，导致减收
- 半导体相关装置、部件等业务，通过获得新客户等，实现增收

2023年 第三季度	晶片再生事业		艾利夏赫 制造销售业务		半导体相关设备 材料等业务		其他，调整金额		合并总计	
	分段 (100万日元)	与去年同期 相比		与去年同期 相比		与去年同期 相比		与去年同期 相比		与去年同期 相比
销 售 额	15,045	15.8%	15,221	△14.3%	10,253	21.7%	△1,049	-	39,470	4.9%
营 业 利 润	5,973	14.2%	3,421	△28.8%	837	30.2%	△655	-	9,576	△2.1%
营业利润率	39.7	△0.6pt	22.5	△7.2pt	8.2	0.6pt	-	-	24.3	△1.6pt

截至2023年12月的第三季度（7月至9月） 结算概况

■ 销售额略有下降

营业利润、经常利润、归属于母公司股东的当期净利润减少

部分PRIME WAFER业务虽然从上一期的特殊需求到环境发生了变化，但在其他业务中并未涵盖销售额。

(100万日元)	2022年12月 第三季度	2023年12月 第三季度	与去年同期相 比	差额
销 售 额	13,440	13,343	△0.7%	△97
营 业 利 润	3,727	3,181	△14.6%	△546
营 业 利 润 比 率	27.7%	23.8%		△3.9pt
经 常 利 润	4,844	4,275	△11.7%	△569
经 常 利 润 率	36.0%	32.0%		△4.0pt
归属于母公司股东 当 期 净 利 润	2,453	2,242	△8.6%	△211
每 股 净 收 益	94.92日元	85.17日元	△10.3%	△9.75日元

截至2023年12月的第三季度（7月至9月）按细分市场的趋势

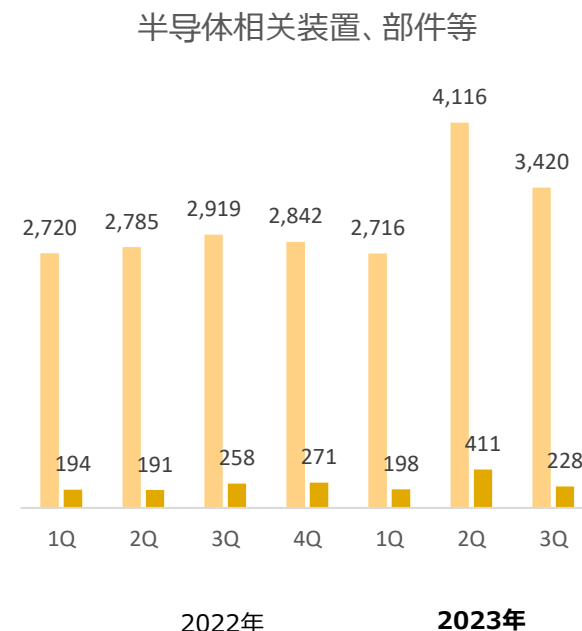
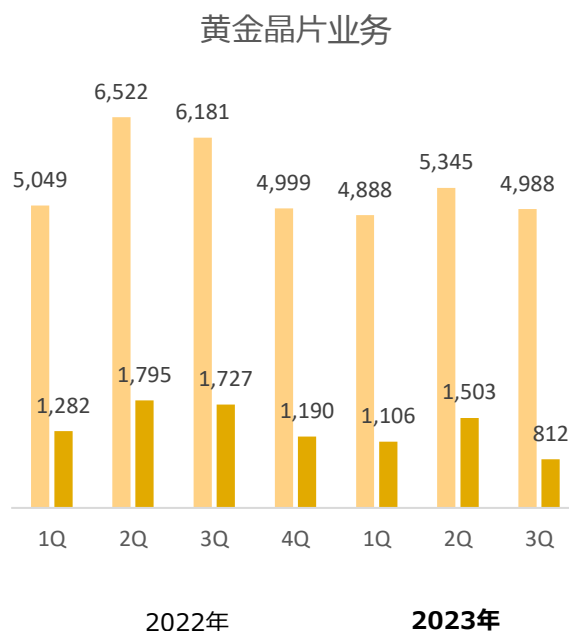
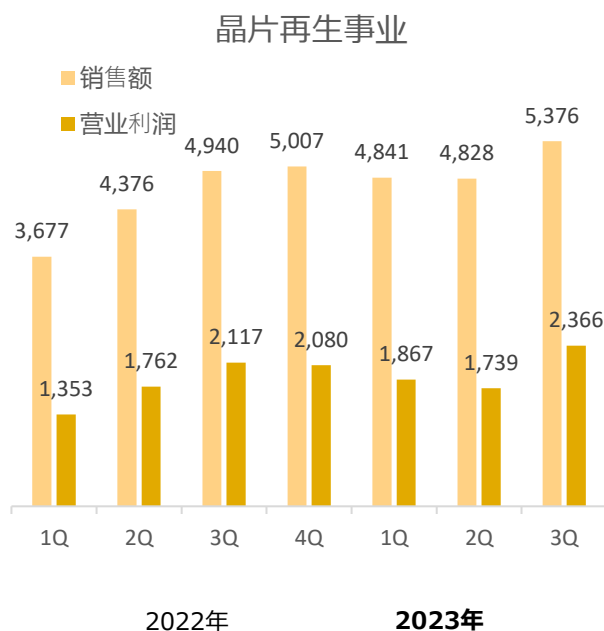
- 由于强劲的客户需求，晶圆再生业务比去年同期增加了收入和利润
- PRIME WAFER业务，因市场环境发生变化等，导致减收
- 半导体相关装置、部件等业务，通过开发新客户等实现增收

2023年 第三季度	晶片再生事业		艾利夏赫 制造销售业务		半导体相关设备 材料等业务		其他，调整金额		合并总计	
	分段 (100万日元)	与去年同期 相比		与去年同期 相比		与去年同期 相比		与去年同期 相比		与去年同期 相比
销 售 额	5,376	8.8%	4,988	△19.3%	3,420	17.2%	△441	-	13,343	△0.7%
营 业 利 润	2,366	11.8%	812	△53.0%	228	△11.6%	△225	-	3,181	△14.6%
营业利润率	44.0	1.1pt	16.3	△11.6pt	6.7	△2.1pt	-	-	23.8	△3.9pt

截至2023年12月的第三季度细分市场趋势季度业绩图

- 由于强劲的客户需求，晶圆再生业务继续稳步发展
- PRIME WAFER业务，因市场环境变化等原因，与上一季度相比减收减益
- 半导体相关装置、部件等业务将继续致力于开拓新客户

(100万日元)



资产负债表

- 净资产:1159亿日元 (比上年末增加144亿日元)
- 现金存款:729亿日元 (由于收入和支出稳步增长, 比上年末增加49亿日元)
- 固定资产:411亿日元(通过实施增产设备投资等, 比上年度末增加40亿日元)
- 有息负债:34亿日元(由于实施了部分偿还, 与上年末相比减少了12亿日元)

合并资产负债表

(100万日元)	2022年12月	2023年12月 第三季度
资产部分		
流动资产	90,470	99,093
现金和存款	67,939	72,872
应收票据和应收账款	11,651	13,086
商品及产品	3,833	6,498
固定资产	37,084	41,107
有形固定资产	31,285	33,548
无形固定资产	270	276
投资其他资产	5,528	7,282
资产总计	127,554	140,200
负债部分		
流动负债	17,622	16,685
应付票据及应付账款	6,466	5,192
有息负债	4,694	3,448
固定负债	8,458	7,632
长期借款	3,514	2,642
负债合计	26,081	24,317
净资产	101,473	115,883
负债与净资产合计	127,554	140,200

3. 中期经营计划

中期经营计划 (3年) 的概要

- 2023财年的销售额受到半导体市场停滞和中美贸易摩擦的影响，但预计将超过2022财年
营业利润虽然有燃料费、材料涨价等，但预计与上年度持平以上。
除2022年度汇率影响等外，普通利润预计将超过上一年度
- 在晶圆再生业务中，我们将根据需求进行及时投资，保持和扩大NO.1的市场份额
- PRIME WAFER业务，应实施稳产和看准市场的投资，扩大市场份额
- 半导体相关装置、构件等业务通过开拓新市场和利用集团协同效应实施增长战略

	2022年 12月	2023年 12月	2024年 12月	2025年 12月
	业绩	规划	规划	规划
销 售 额	49,864	50,800	54,900	57,600
营 业 利 润	13,018	13,100	14,000	14,700
营 业 利 润 比 率	26.1%	25.8%	25.5%	25.5%
经 常 利 润	15,500	14,300	15,400	16,100
经 常 利 润 率	31.0%	28.1%	28.1%	28.0%
归属于母公司股东的 当期净利润	7,739	7,400	7,600	8,000
每 当 期 净 利 股 润	299.29	286.18	293.91	309.38

截至2023年12月期 决算业绩预测

- 销售额增加， 营业利润的材料和燃料价格上涨， 但预计将超过上一年
虽然经常利润有所减少， 但除2022年度汇兑收益等特殊因素外， 预计上一年度及以上

(100万日元)	2022年12月 (2022年1月至12月)	2023年12月 (2023年1月至12月)	前期比	
	全年业绩	全年预测	增减	增减率
销售额	49,864	50,800	+936	+1.9%
营业利润	13,018	13,100	+82	+0.6%
营业利润比率	26.1%	25.8%	△0.3Pt	
经常利润	15,500	14,300	△1,200	△7.7%
经常利润率	31.0%	28.1%	△2.9Pt	
归属于母公司股东的当期净利润	7,739	7,400	△339	△4.4%
每股净收益	299.29	286.18日元	△13.11	△4.4%
年度红利	35.0日元	35.0日元	-	-

*从本会计年度开始， 合并后的本期决算预测数值不按公司披露。
这是RS Technologies根据目前相关公司的信息总结的预测。

设备投资计划:晶圆再生业务

- 随着全球对半导体需求的扩大,日本和台湾的产量继续扩增,并在中国山东省开始量产。
- 为应对需求决定增加台湾的2023年度及2025年度投资额、2025年预计达到月产28万片。

日本

总投资额:25亿日元

- 12英寸再生晶圆的产能扩充及小型化对策
- 2023年至2025年:25亿日元 (4万片)

12英寸再生晶圆生产能力 (月产)

2022年	2023年	2024年	2025年
30万片	31万片	32万片	34万片

2023年	2024年	2025年
10亿日元	2亿日元	13亿日元

台湾

总投资额:36亿日元

- 12英寸再生晶圆的产能扩充及小型化对策
- 2023年至2025年:36亿日元 (8万片)

12英寸再生晶圆生产能力 (月产)

2022年	2023年	2024年	2025年
20万片	23万片	26万片	28万片

2023年	2024年	2025年
11亿日元	10亿日元	15亿日元

中国

总投资额:36亿日元

- 投资新建12英寸再生晶圆生产基地
- 第一期投资 (2021年至2023年):
36亿日元 (5万片)
- 第二期投资 (2024年):
投资额未定 (5万片)

12英寸再生晶圆生产能力 (月产)

2022年	2023年	2024年	2025年
5万片	5万片	5万片	10万片

第一期投资

2023年	2024年	2025年
1亿日元	未定	未定

※35亿日元已于2022年投资

设备投资计划:PRIME WAFER事业

- 8英寸PRIME WAFER计划每月产量从13万片增加到18万片
- 12英寸PRIME WAFER将于2023年导入月产5万片的量产设备，计划于2024年投入运营。

中国 8英寸

- 建立稳定的批量生产系统，提高生产效率

8英寸PRIME WAFER产能 (月产)

2022年
13万片 → 2024年
18万片

2023年	2024年	2025年
20亿日元	4亿日元	未定

中国 12英寸

- 12英寸的PRIME WAFER量产化的研究开发
- 以从1万片的试验线转化到30万片的量产体制为目标

12英寸PRIME WAFER产能 (月产)

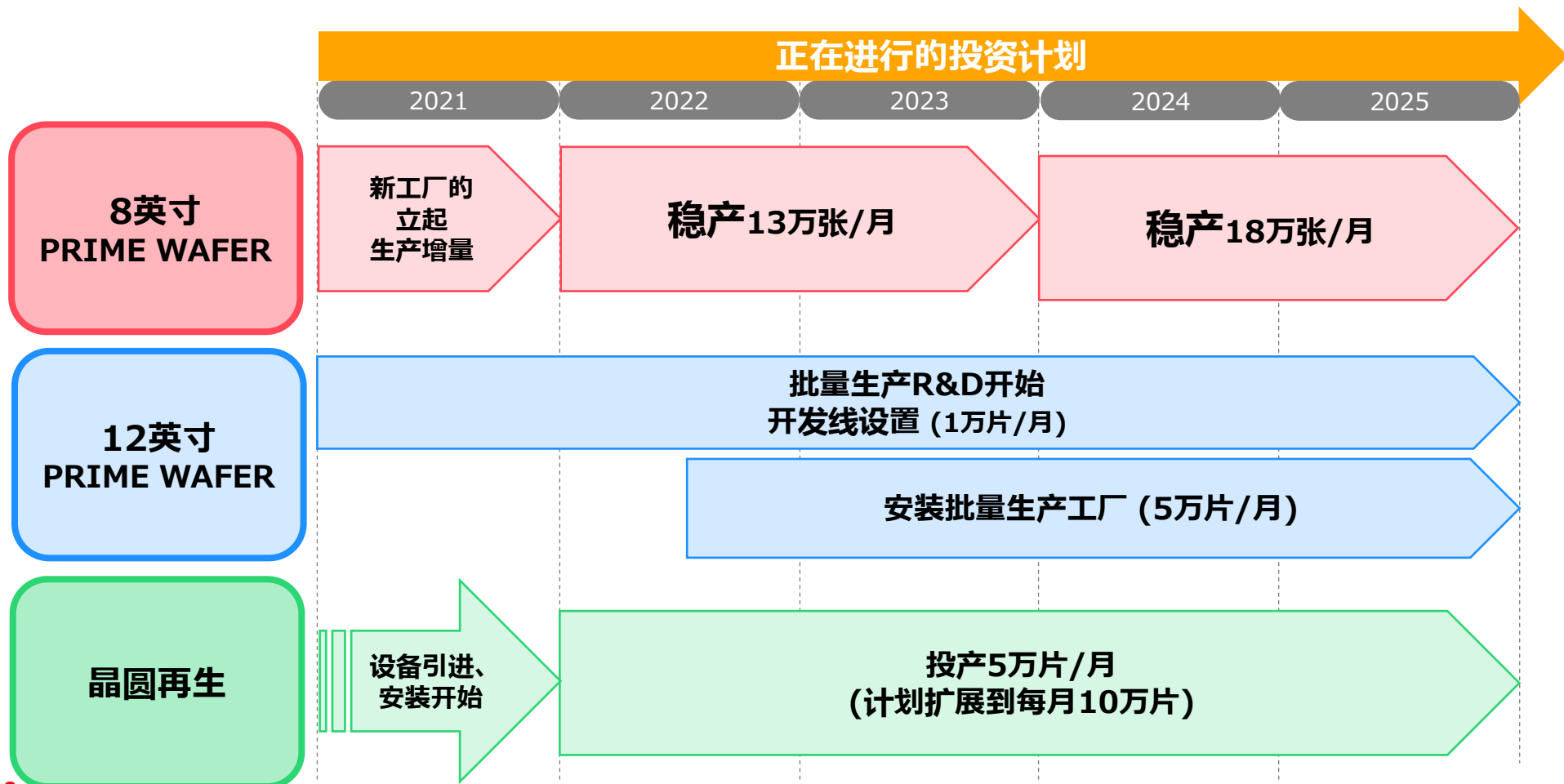
2022年
1万片※1 → 2024年
6万片 → 202X年
30万片

2023年	2024年	2025年
240亿日元 ※2	20亿日元 ※2	未定

※1用于量产化研究开发的开发生产线
※2 12英寸业务是权益法适用公司的投资。

中国投资计划 (时间表)

- 8英寸PRIME WAFER从每月13万片增加到18万片
- 12英寸PRIME WAFER将设置月产5万片的量产生产线, 力争早日实现高品质、稳定生产
- 晶圆再生业务继续月产5万片的量产



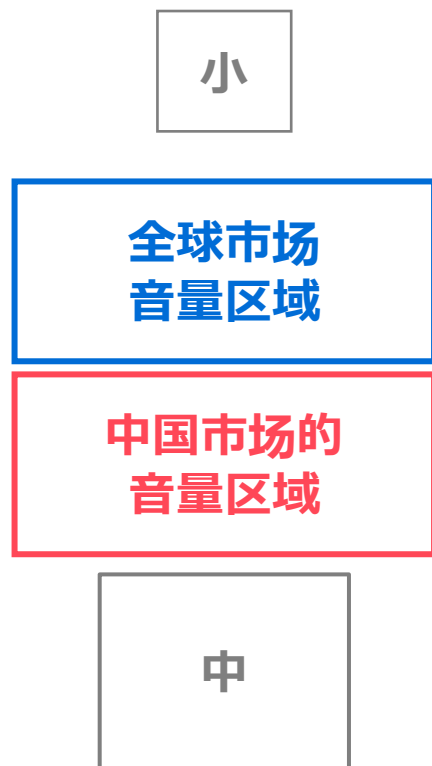
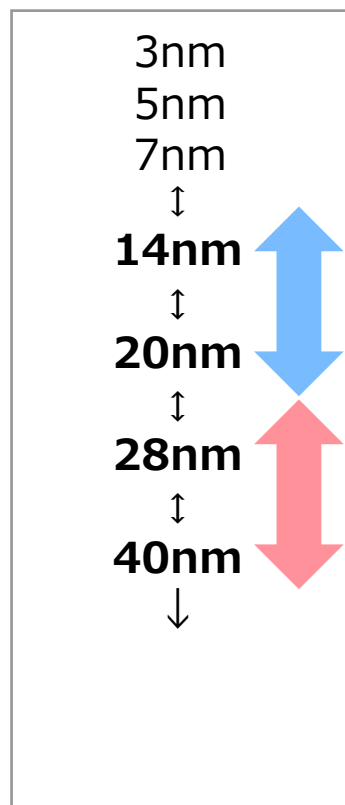
中国12英寸PRIME WAFER市场战略

- 确保中国主要量化产品的品质，活用M&A等形式争取中国市场占有率No.1。
- 在实现中国市场占有率No.1的同时，实现全球品质要求，并开始向硅片再生客户群体（半导体全球厂商）销售Prime wafer，成为全球通用Prime wafer厂商。

半导体市场的技术水平和市场规模

技术水平

市场规模



中国Prime wafer的市场战略

以确保全球质量为目标

品质:达到全球品质
价格:中国生产实现低价格
销售:通过晶圆赛再生客户群体

↓
实施全球销售，目标市场份额为30%

12英寸Prime Wafer的品质目标

品质：确保中国市场的量化区域的产品品质
↓
价格：活用M&A等，以低成本的设备成本来实现低价格
↓

实现中国市场份额No1

晶圆再生业务的需求:12英寸半导体新工厂

- 为了满足中、欧、日等国家因存储器、CPU、汽车电子化等而产生对半导体强劲的需求，12寸半导体新工厂正在建设中。
- 通过对日本、台湾及中国的设备投资，对应新的再生片需求。



注:RST检查

地域战略

■ 再生晶圆

- 三本木工厂主要在北美，欧洲，日本等地进行交易
- 台湾工厂主要在台湾交易
- 中国以中国国内为中心进行交易

■ Prime wafer

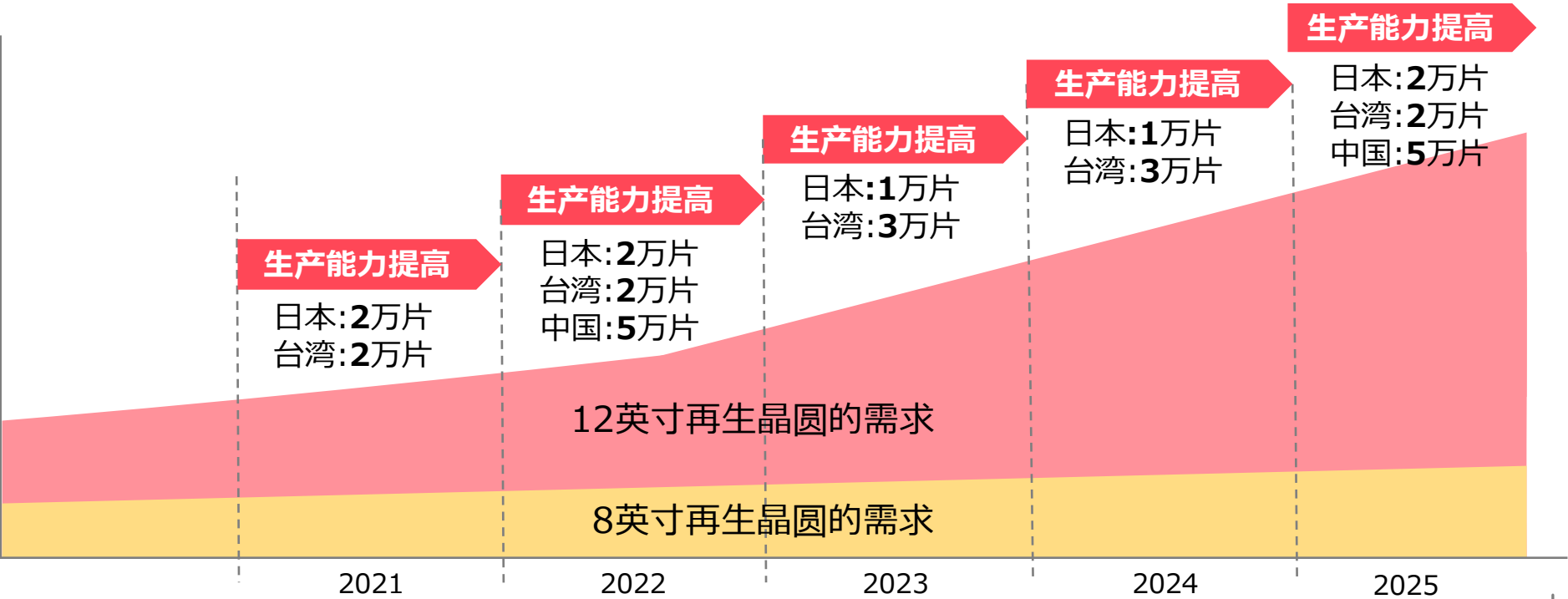
- 销售地点主要在中国



再生晶圆的需求前景:12英寸为中心持续扩大

■为满足不断扩大的再生硅片需求，预计2023~2025年分别实现日本4万片、台湾8万片、中国5万片的产能提高。

生产能力	2021年底	2022年底	2023年底	2024年底	2025年底
日本	28万片	30万片	31万片	32万片	34万片
台湾	18万片	20万片	23万片	26万片	28万片
中国	0万片	5万片	5万片	5万片	10万片
总计	46万片	55万片	59万片	63万片	72万片



第3成长引擎：DG Technologies的成长战略 (1/3)

- DG Technologies是为大型半导体制造商及半导体设备制造商提供消耗零件的零件制造商。
- 2019年1月成为本公司的子公司。

公司概况



公司的名字	株式会社 DG Technologies
设 立	1981年10月26日
业 务 内 容	制造并销售半导体制造装置用的消耗零件
所 在 地	茨城县神栖市砂山3-4
资 本	100,000千日元
董 事 长	方永义

产品

干式刻蚀装置
石英、硅消耗品



硅电极



石英环

主要客户

半导体制造厂商
半导体设备制造商等

第3成长引擎: DG Technologies的成长战略 (2/3)

- 干蚀刻设备用零件市场预计为1500亿日元*1，预计今后会增长。
- 决策并执行生产能力扩大与生产效率化相关的成长战略以及由RS既存硅片顾客的销售与GRITEK的采购产生的协同作用。目标是占据该市场第一。

市场的成长性

干式刻蚀装置
石英、硅消耗品市场



约1500亿日
元*1

期待和干蚀刻设备市场同
比例的成长

(发行指标)

干蚀刻设备市场



增长率
8% *2

成长战略

- ◆ 经营活动的强化
对RS既存硅片顾客进行交叉销售
- ◆ 生产能力的增强
进行设备投资，构建体制及时生产供货满足顾客的要求
- ◆ 提高生产效率
增强生产能力，实现人员及生产工程的最优化，提高生产效率
- ◆ 采购最优化
从本集团的公司GRITEK采购原材料，强化竞争力

第3成长引擎: DG Technologies的成长战略 (3/3)

- 因神栖工厂已负荷运行，为应对不断继续扩大的顾客需求，2021年5月设立了宫城县栗原工厂。
- 有以前的神栖工厂与新设的栗原工厂，合计2个生产据点对应增加的订单。

神栖工厂



工厂名称

DG Technologies 神栖工厂

所在地

茨城县神栖市

建筑面积

5,378m²

栗原工厂



工厂名称

DG Technologies 栗原工厂

所在地

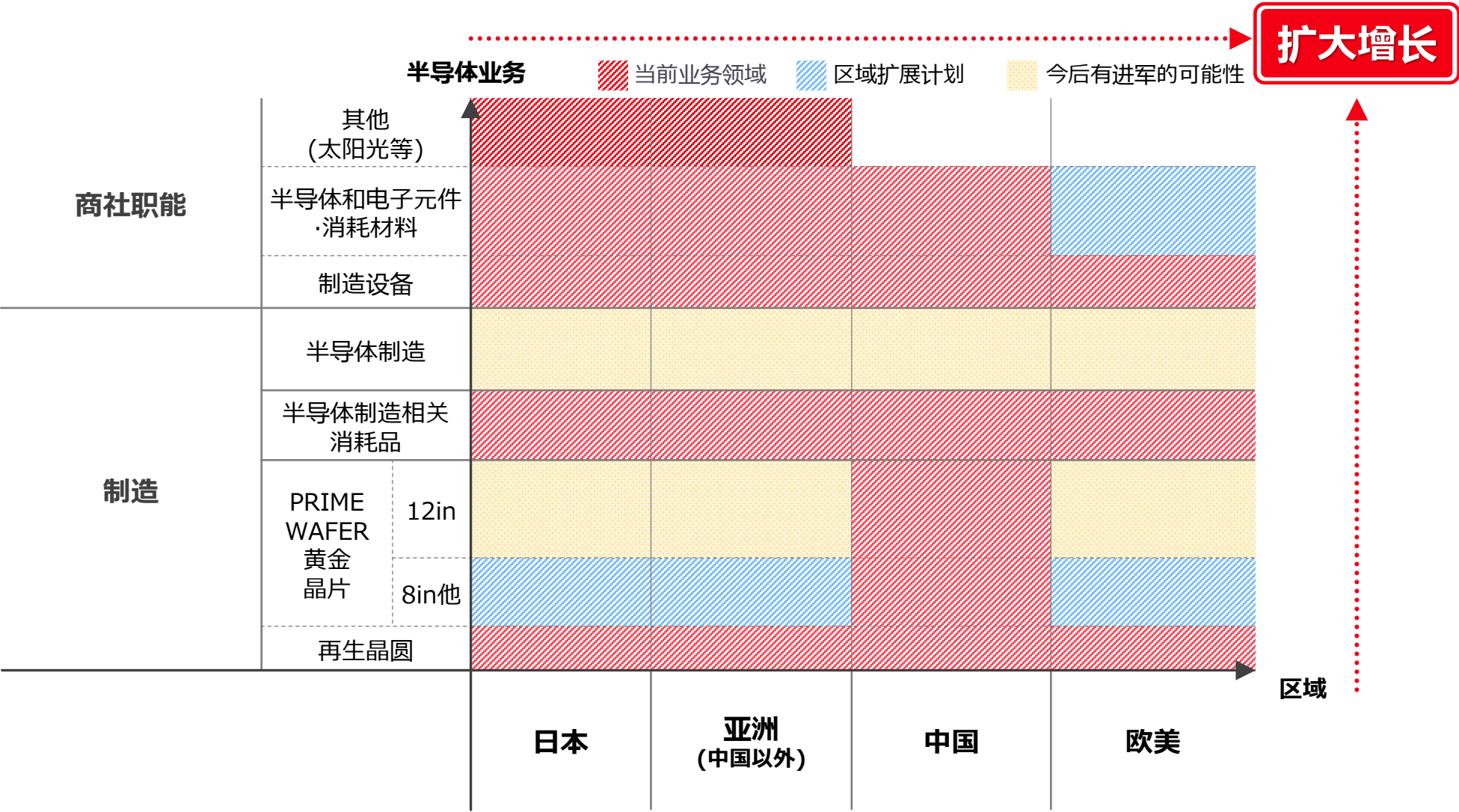
宫城县栗原市

建筑面积

5,000m²

RS Technologies的愿景

■ 我们将逐步稳步扩大业务领域和销售区域。



Appendix

董事长 方永义的优势

- 董事长总经理方永义的优势是可灵活运用20多年来在日本积累的见识和广泛人脉，并拥有面向全球的营销能力、人际关系、合作能力及资金实力。
- 方永义麾下集结了高科技、金融等广泛领域的专业人才。



方 永义

1970年出生 中国福建省人
城西国际大学 经营学博士

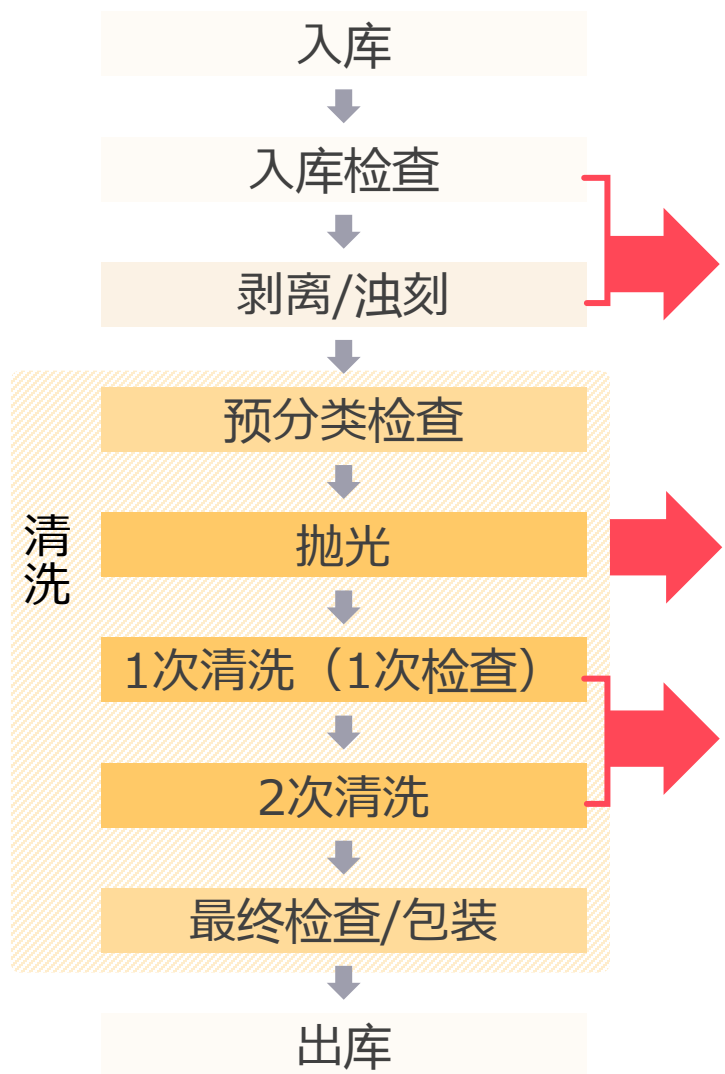
擅长领域：
M&A、业务合作（过去成功并购了超过10家企业）

1998年 成立永辉商事
2010年 成立本公司并就任总经理（现任）

座右铭：事在人为

补充：
高中毕业后来日。拥有日本国内外的20多家公司的投资经验。除半导体业务外，还有基金、贸易、酒店、IT业务、农业等各种行业的投资经验。以“日本的制造服务世界第一”为信条，奔走于世界各地，向全球推广日本的制造服务。

晶圆再生业务(1)



强项1

所有膜剥离

- 因通过化学方式进行剥离，对表面的损伤最小

▶ 再生次数多

▶ 可降低成本

继承了拉萨工业（化学）的特技



通过抛光去除表面杂质使其平滑

强项2

金属不纯物的去除

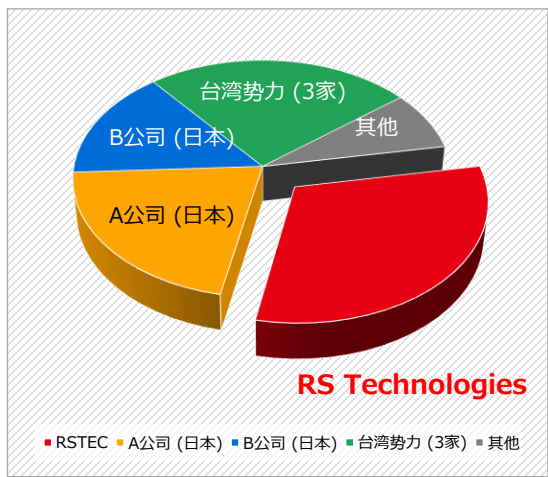
- 通过洗净除去硅片表面的细微杂质
- + 金属杂质的去除, 尤其擅长铜 (Cu) 的除去



晶圆再生业务 (2)

本公司再生市场份额的扩展

本公司在12英寸硅片市场上所占的份额



注:RST检查

由于增设了台湾工厂和三本木工厂，生产能力提高了，目前的市场份额已上升到约33%。

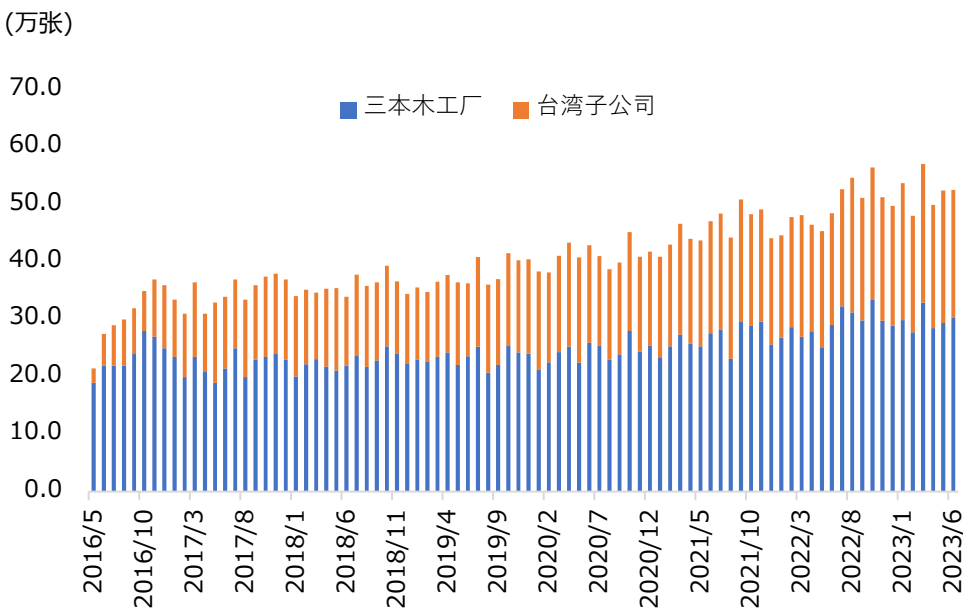
旨在通过利用两家工厂的现有设施提高生产力，利用三本木的空工厂，业务合作和并购等方式进一步扩大市场占有率。

年	2015下半年	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
生产能力	24万片	28万片	30万片	34万片	40万片	42万片	46万片	50万片
份额	24%	29%	30%	31%	33%	33%	33%	33%

注:RST检查

三本木工厂和台湾子公司的出货量

3本木工厂和台湾子公司12英寸晶圆出货量趋势



进军PRIME WAFER行业

- 与中央政府直属企业北京有色金属研究总院（现为有研科技集团有限公司）成立合资公司。作为国内内资企业（中国国内公司）发展半导体业务



本公司与有研的合作效应

强项1

在中国销售时有作为国内企业的优势

强项2

享受中国半导体措施带来的好处

强项3

通过RS的全球销售网络向全球客户销售

强项4

利用RS再生处理技术

- 我们拥有30多年的见解与见识

关于我们在中国的合资伙伴 (GRINM)

- 成立于1952年。**中国有色金属领域最大的国有研究机构。**
- 在中国大约4,500万家公司中，国有企业有46万家。
- 其中，中央政府直属企业有97家，GRINM是其中之一。
- 这是一个集政府，产业和学术界于一体的研究机构，
- 中央政府在有色金属领域的政策是通过该公司宣布的。
- 将研究成果事业化。目前，拥有4个综合研究院及30家事业单位（其中涵盖2家上市公司）
- 本公司的合资子公司GRITEK是在北京有研艾斯半导体科技有限公司（BGRS）
- 伞下成立于2001年的第一家事业公司。



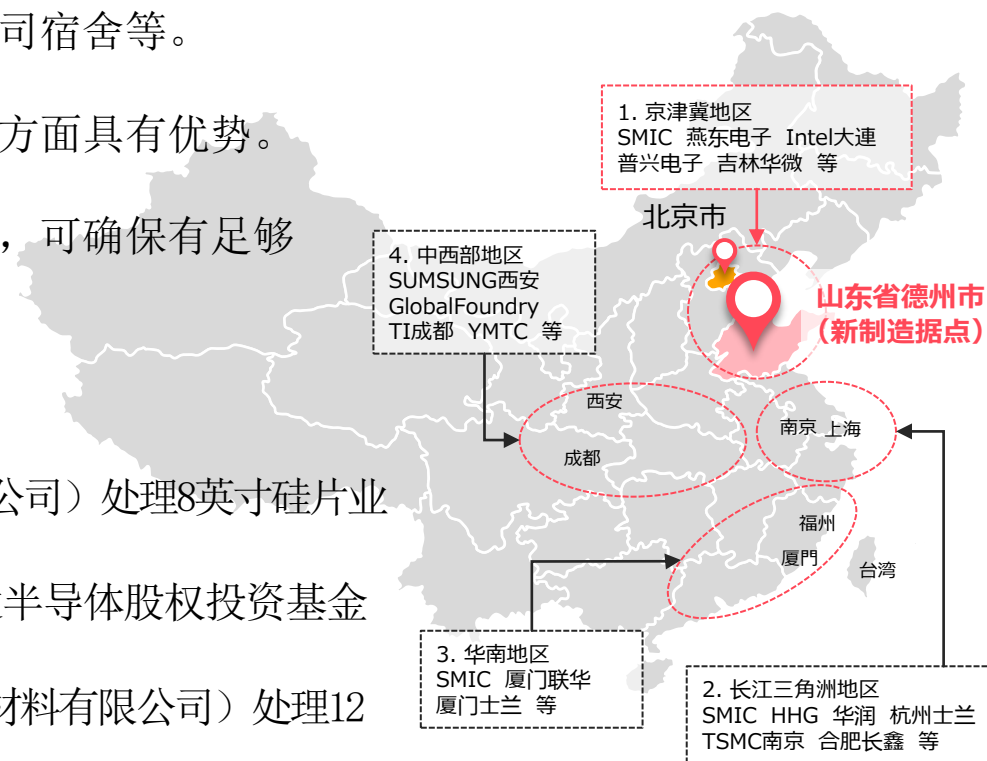
与山东省德州市的合作：背景、经过及现状（山东有研新工厂竣工）

合作背景

1. 世界主要半导体制造商被吸引到周边地区建工厂，是靠近半导体制造商聚集地的良好位置（请参照右图）
2. 福利待遇优厚，例如减免水电费及提供廉价的公司宿舍等。
3. 附近有一所理工系大学，在获得优秀的人力资源方面具有优势。
4. 该基地最大可扩展至约50万m²（最初为20万m²），可确保有足够的用地来应对未来在中国的业务推进。

经过和现状

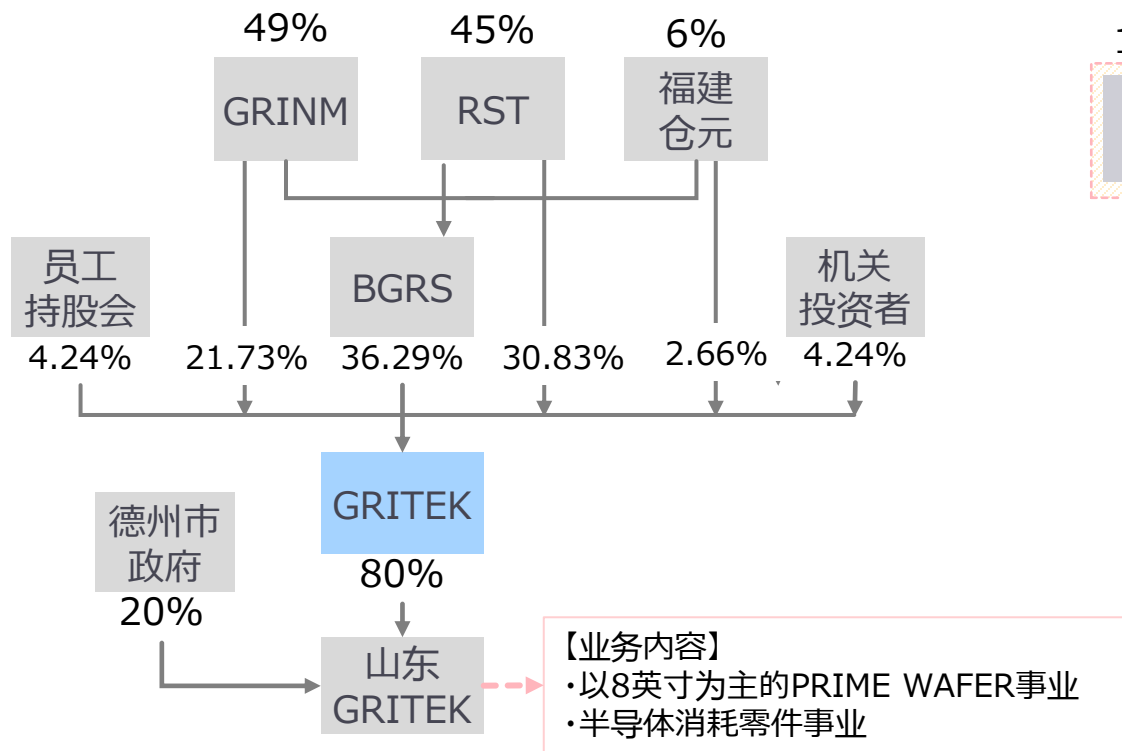
1. 2018年8月成立新公司（山东有研半导体材料有限公司）处理8英寸硅片业务。
2. 2019年12月与有研科技集团有限公司、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业及山东省德州市政府签订四方合资合同。
3. 2020年3月成立新合资公司（山东有研艾斯半导体材料有限公司）处理12英寸硅片业务。
4. 2020年10月举行德州市新工厂竣工仪式。



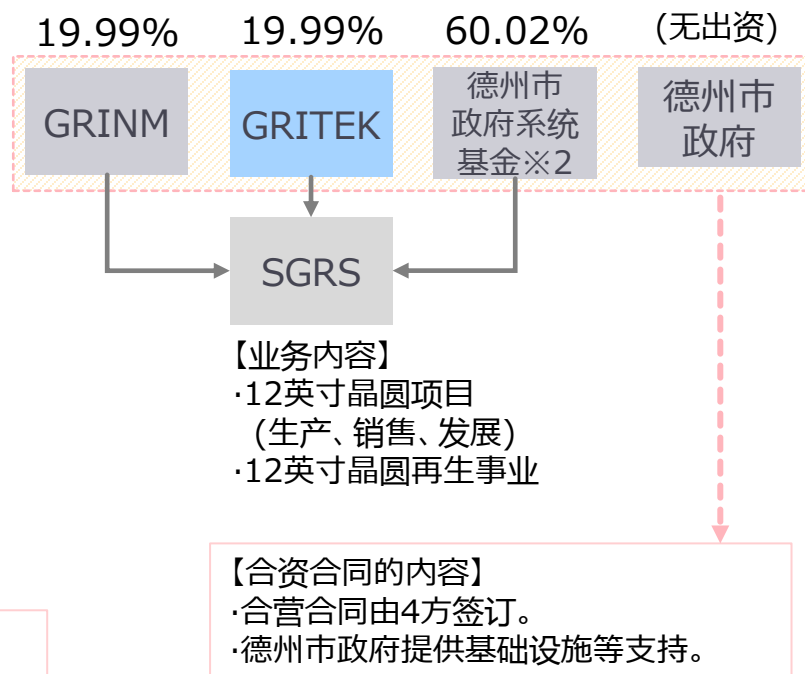
中国业务的出资方案

- 作为上市准备的一环，董事会决议实施部分股权转让，转让BGRS持有的部分GRITEK股份
- （2020年11月公开），转让GRITEK第三方发行的新股及本公司权益控股公司（SGRS）的股份
- （2021年5月开示）。
- 上述披露内容实施后的出资形态如下。

8英寸晶圆业务出资形态※1



12英寸晶圆业务出资形态※1



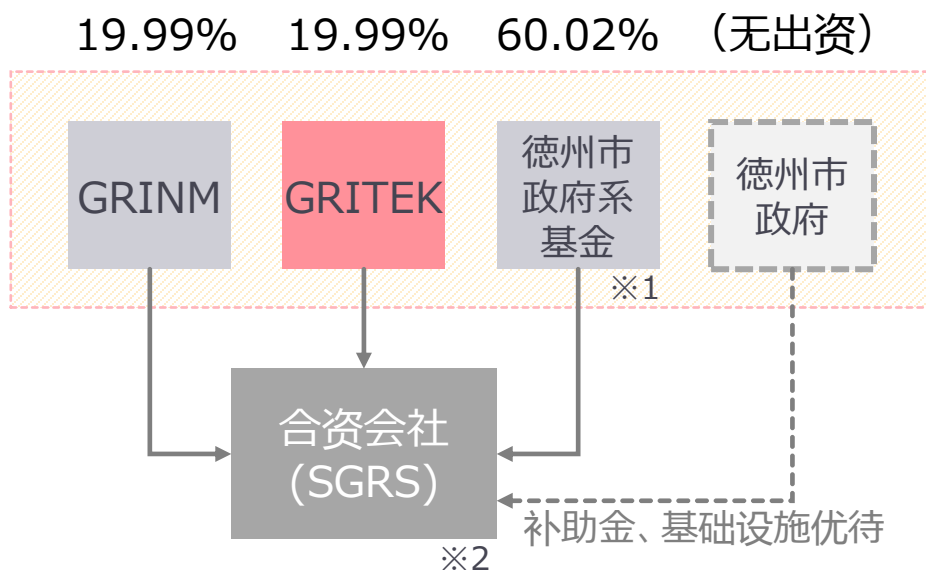
※1披露日期为2021年5月19日的披露材料《（披露事项进展）关于子公司第三方配股及转让本公司股权法公司股份为境外子公司上市做准备的通知》公司”显示执行后的投资形式。在SGRS的投资比例为最终投资比例，对公司的投资将根据投资协议分阶段进行。

※2 德州汇达半导体股权投资基金合伙企业

中国12英寸PRIME WAFER业务的出资方案

- 2021年5月，董事会决议将本公司持有的SGRS股份转让（换股）给GRITEK。
- 由于此次转让，SGRS 将成为我们合并子公司 GRITEK 的控股公司（转变为通过 GRITEK 间接控股）。
- 通过GRITEK从事12英寸PRIME WAFER业务将有助于实现PRIME WAFER业务战略。

SGRS股份转让后的投资方案



本次转让中的方案变更点

- ◇ SGRS成为 GRITEK 的权益法控股公司
 - 实现中国硅业务一体化管理
 - 被认定为实现优秀硅产业战略做出贡献
- ◇ 本公司方董事长将继续兼任SGRS董事长。
 - 通过我们的子公司 GRITEK 继续控制
- ◇ 本公司的权利和义务由 GRITEK 全面继承
 - 通过 GRITEK，可以行使之前拥有的权利

中国子公司 (GRITEK) 的上市和资本政策

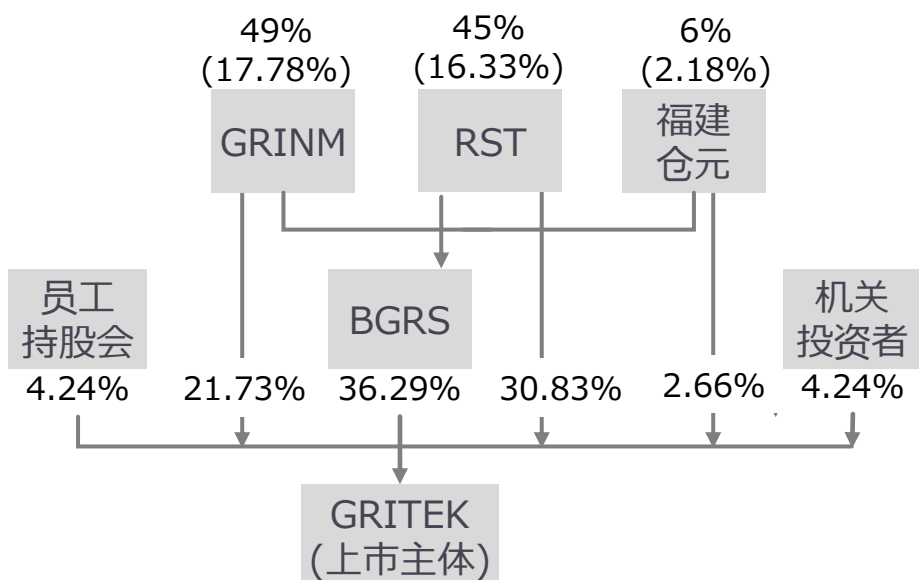
■中国子公司 (GRITEK) 于2022年11月在上海证券市场科创板上市

■实施公募增资，资本结构发生以下变化：

上市前的资本构成

2021年5月19日披露资料“(披露事项的经过) 伴随本公司海外子公司的上市准备，该子公司进行的第三方配股增资及本公司权益法适用公司的股份转让的通知”披露内容后的出资形式。

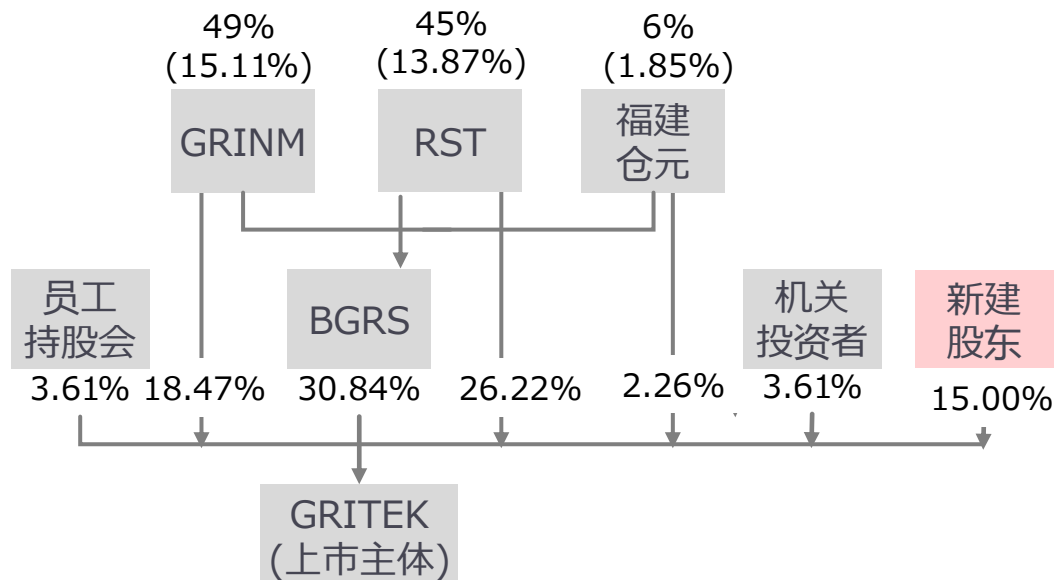
上半部分:BGRS持股
下半部分: (GRITEK间接持股)



上市时的资本构成

<新发行股票的数量>
187,143,158股 (已发行股份总数的15%)
<采购金额>
约375亿日元

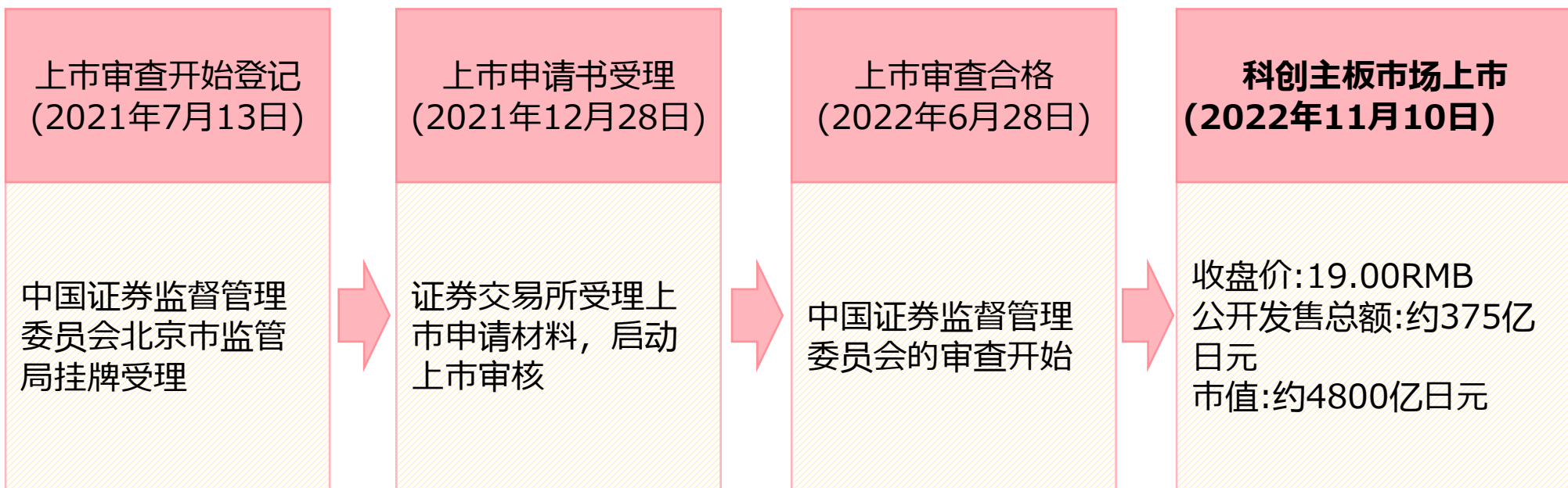
上半部分:BGRS持股
下半部分: (GRITEK间接持股)



中国子公司 (GRITEK) 上市时的状况

- 2021年12月28日, 上海证券交易所受理中国子公司 (GRITEK) 提交的科创板市场的上市申请书, 开始上市审查。
- 2022年11月10日在上海证券交易所科创板上市
- 公开发售价格为9.91RMB, 11月10日的收盘价为19.00RMB
基于收盘价的市值约为4800亿日元

上市时间表



※汇率是11月9日 TTM汇率 (20.14日元)

业绩推移

(100万日元)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
销售额	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561	34,620	49,864
销售毛利	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681	11,870	18,432
管理费	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151	4,995	5,413
营业利润	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530	6,874	13,018
经常利润	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252	8,832	15,500
当期利润*	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824	3,303	7,739
股息 (日元)	-	-	-	10	5	10	15	20	25	35
设备投资	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	12,409	7,827	5,379
折旧费	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674	2,942	3,498
研发费用	1	6	11	85	183	501	449	929	1,308	1,657
员工数 (正式员工) (人)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187	1,333	1,533

※归属于母公司股东的当期净利润

主要财务报表

(100万日元)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
资产部分										
流动资产	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626	45,804	90,470
现金和存款	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082	25,438	67,939
应收票据和应收账款	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321	9,517	11,651
商品及产品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116	2,783	3,833
固定资产	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124	33,206	37,084
有形固定资产	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146	29,023	31,285
无形固定资产	19	15	29	23	19	1,099	732	527	417	270
投资其他资产	27	130	148	158	149	453	506	1,451	3,766	5,529
资产总计	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554
负债部分										
流动负债	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631	14,171	17,622
应付票据及应付账款	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871	4,317	6,466
有息负债	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522	3,020	4,694
固定负债	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754	9,827	8,458
长期借款	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613	5,097	3,514
负债合计	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385	23,999	26,081
净资产的部分										
净资产	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365	55,011	101,473
负债与净资产合计	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554

*2013年12月期是单独结算。

各事业业绩推移

(100万日元)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
销售额										
晶片再生事业	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461	12,717	18,001
金箔生产销售业务	-	-	-	-	-	11,918	10,058	8,755	14,780	22,752
半导体生产设备的收购与销售	-	-	-	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272	8,450	11,265
其他, 调整金额	127	151	178	66	52	△331	△380	△927	△1,327	△2,154
分段利润										
晶片再生事业	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027	4,731	7,312
金箔生产销售业务	-	-	-	-	-	2,048	1,503	1,041	2,539	5,995
半导体生产设备的收购与销售	-	-	-	230	130	366	171	211	382	914
其他, 调整金额	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749	△778	△1,203
分段资产										
晶片再生事业	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698	14,302	18,530
金箔生产销售业务	-	-	-	-	-	21,313	29,311	35,697	53,202	95,788
半导体生产设备的收购与销售	-	-	-	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387	7,310	6,801
其他, 调整金额	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968	4,243	6,435

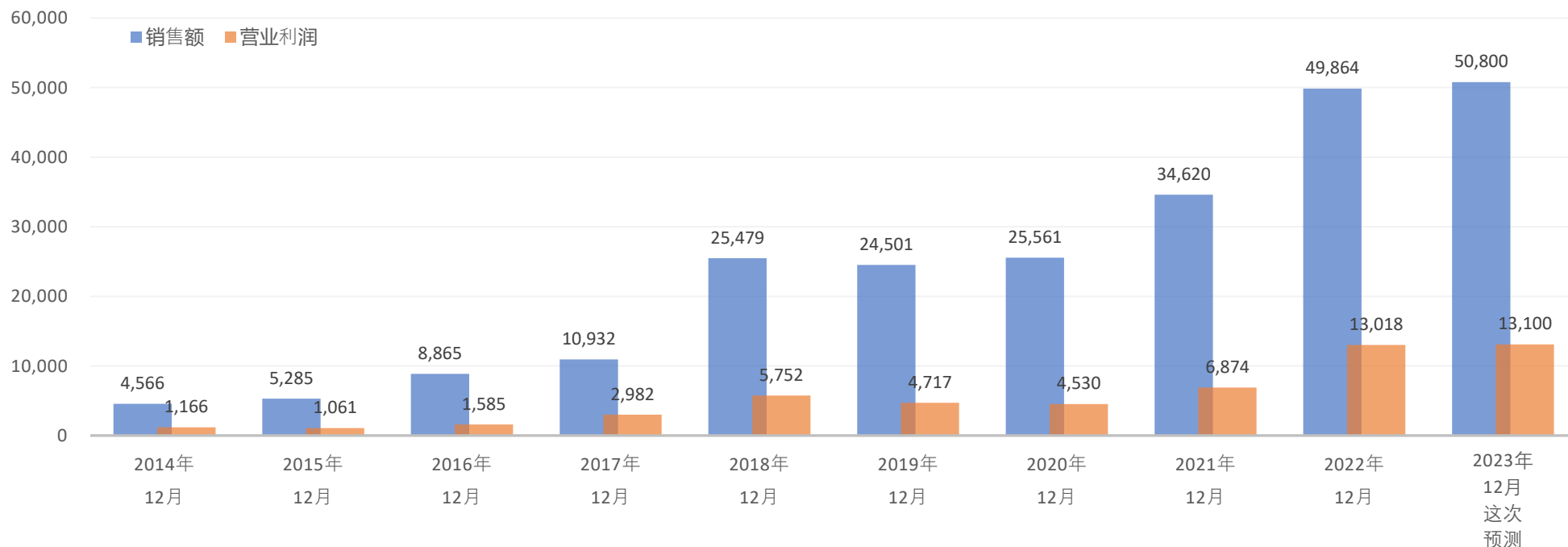
*2015年, 2016年和2017年的结算数字是2019年3月5日发布的更正后的数字。

连结业绩推移

- 2014年2月，在台湾成立艾爾斯半導體股份有限公司（RSTW）。2015年12月，台南工厂竣工。
- 2015年6月，配备最先进设备（可再生18英寸硅片）的三本木工厂和第8工厂竣工。
- 2018年1月，中国主要硅片制造商有研半导体材料有限公司(GRITEK) 成为合并子公司。
- 2020年10月，中国山东省德州工厂建成并作为PRIME WAFER制造基地投入运营。
- 2022年11月， GRITEK在上海证券交易所科创板上市

合并销售和营业收入

(100万日元)



本资料中记载的内容，是在一般认为的经济形势和本公司认为合理的一定前提下制作的，若因外部经营环境的变化而更改，恕不提前通知。

在本次发布时获得的资料和信息当中，包括“预测信息”。这些信息是根据现在的估计、预测以及带有风险的假设得出的，含有不确定性，也许与实际结果相左。

即使今后出现新的信息、事情等，本公司也不承担更新和修正本次发布所含的“预测信息”的义务。